行政院農業委員會農業試驗所專利權讓與意願書

附 件

申請日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 申請讓與專利權項目 | □溫帶果樹高接花穗生產方法□BIOREACTOR FOR GROWING FUNGUS, PLANT CELL, TISSUE, ORGAN, HAIRY ROOTS AND PLANTLET (美國專利)□自走式鑽孔施肥機□米粒方型包裝自動化設備 |
| 申請業者基本資料 | 公司名稱：代表人：電 話： 傳 真：電子郵件：聯絡人： 職 稱：電 話： 傳 真：連絡地址：電子郵件： |

申請公司： (公司印信) 代表人： (簽章)